

定穎投控2025年第三季 營運成果報告

Nov. 14, 2025

市場資訊

2025年第三季營運概況

未來展望

定穎在ESG的作為

免責聲明

除歷史事件之陳述外，本簡報中前瞻性的敘述因受制於未知風險及不確定性，可能導致實際營運結果與該前瞻性敘述產生重大差異。

本簡報中前瞻性的敘述，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整，本公司不負責隨時提醒或更新。

市場資訊

伺服器、儲存與人工智慧 (AI) 市場

人工智慧 (AI) 基礎設施正經歷爆發性成長，並帶動新技術、新產品與新供應鏈的發展。
Prismark 預估 Computing ASIC 2024~2029 產值的年複合成長率為27.4%；GPU 和 HPC server產值的年複合成長率為21%。

24-29 CAAGR		Units (M)	Value (\$Bn)
	Storage Equipment	4.8%	3.1%
	Computing ASIC	26.9%	27.4%
	GPU and HPC Server	17.2%	21.0%
	Regular Server	5.0%	2.5%
Total		7.1%	14.6%

人工智慧 (AI) 的泡沫疑慮

- 人們擔憂，整體對人工智慧 (AI) 的投資可能正在形成泡沫，類似於網路泡沫 (dot-com bubble) 。
- AI資料中心的投資主要集中於服務提供商層面，而非終端使用者。
- 資本支出 (Capex) 遠高於營收：例如：OpenAI年營收約為120至130億美元，但僅向Oracle支付資料中心租用費就高達每年約600億美元。在未來幾年，產業整體資本支出預估約5,000億美元，為了實現投資報酬率 (ROI)，必須有更高的營收支撐，若營收不足，將迫使多數AI產業參與者依賴舉債，這增加了他們的成本與風險。
- 產權結構可能帶來循環投資風險：例如：Nvidia投資OpenAI，而OpenAI租用 CoreWeave或Oracle的資料中心，而這些公司又向Nvidia購買硬體。這種結構不一定立即成為問題，但確實可能增加潛在風險。

PCB的需求 – 產品應用

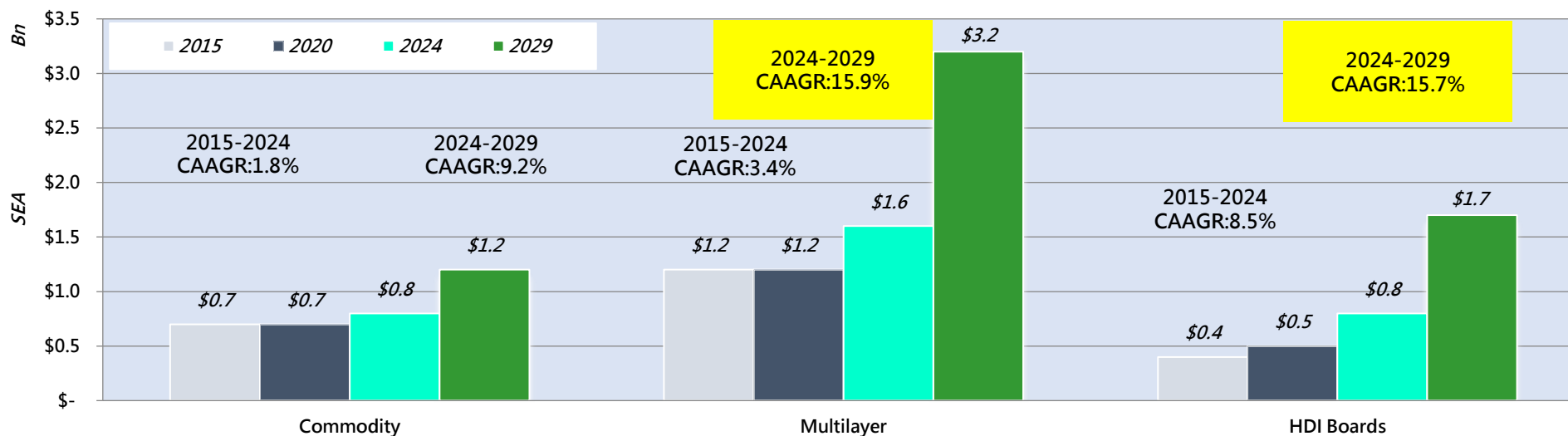
\$M	2020	2023	2024	2025F	2029F	2025F/2024	2024-2029F CAAGR
Computer: PC	\$11,210	\$9,391	\$9,429	\$10,050	\$11,102	6.60%	3.30%
Server/Data Storage	\$5,876	\$8,201	\$10,916	\$15,015	\$22,546	37.50%	15.60%
Other Computer	\$3,801	\$3,661	\$3,649	\$3,820	\$4,110	4.70%	2.40%
Mobile Phones	\$14,150	\$13,085	\$13,886	\$14,602	\$17,410	5.20%	4.60%
Wired Infrastructure	\$4,958	\$5,955	\$6,153	\$7,924	\$10,853	28.80%	12.00%
Wireless Infrastructure	\$2,771	\$3,118	\$3,177	\$3,551	\$4,302	11.80%	6.30%
Consumer	\$9,366	\$9,129	\$8,972	\$9,488	\$10,235	5.80%	2.70%
Automotive	\$6,457	\$9,153	\$9,195	\$9,682	\$11,269	5.30%	4.20%
Industrial	\$2,543	\$2,871	\$2,918	\$3,151	\$3,761	8.00%	5.20%
Medical	\$1,263	\$1,440	\$1,500	\$1,598	\$1,856	6.50%	4.30%
Military/Aerospace	\$2,824	\$3,514	\$3,770	\$4,107	\$5,021	8.90%	5.90%
Total	\$65,218	\$69,517	\$73,565	\$82,987	\$102,466	12.80%	6.90%

PCB的需求 – 產品技術

	2000	2020	2022	2023	2024	2025E	2029F	2025E/ 2024	2024- 2029 CAAGR
Commodity	\$10,324	\$7,911	\$8,875	\$7,757	\$7,947	\$8,281	\$9,286	4.2%	3.2%
Multilayer	\$22,217	\$24,763	\$29,846	\$26,534	\$27,994	\$31,897	\$38,330	13.9%	6.9%
HDI	\$2,074	\$9,874	\$11,763	\$10,536	\$12,518	\$15,717	\$20,120	25.6%	9.5%
Package Substrate	\$3,505	\$10,188	\$17,415	\$12,498	\$12,602	\$14,215	\$19,686	12.8%	9.3%
Flex	\$3,450	\$12,483	\$13,842	\$12,191	\$12,504	\$12,877	\$15,044	3.0%	3.8%
TOTAL	\$41,570	\$65,219	\$81,740	\$69,517	\$73,565	\$82,987	\$102,466	12.8%	6.9%

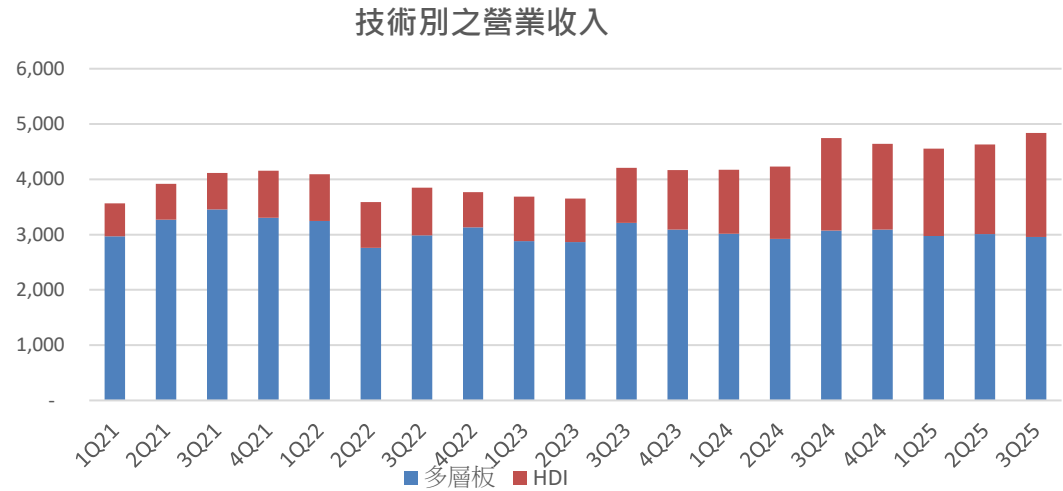
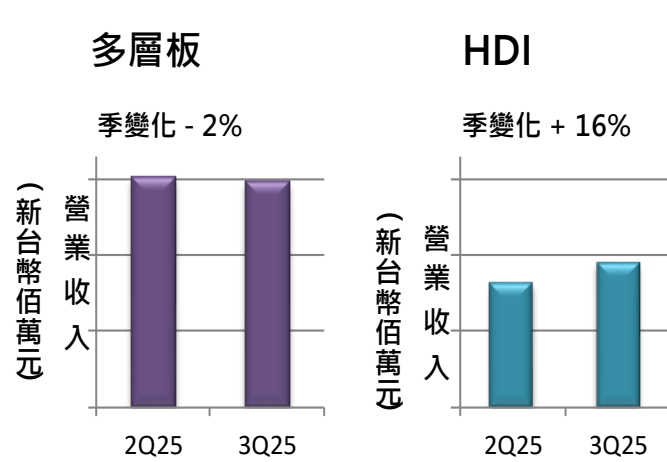
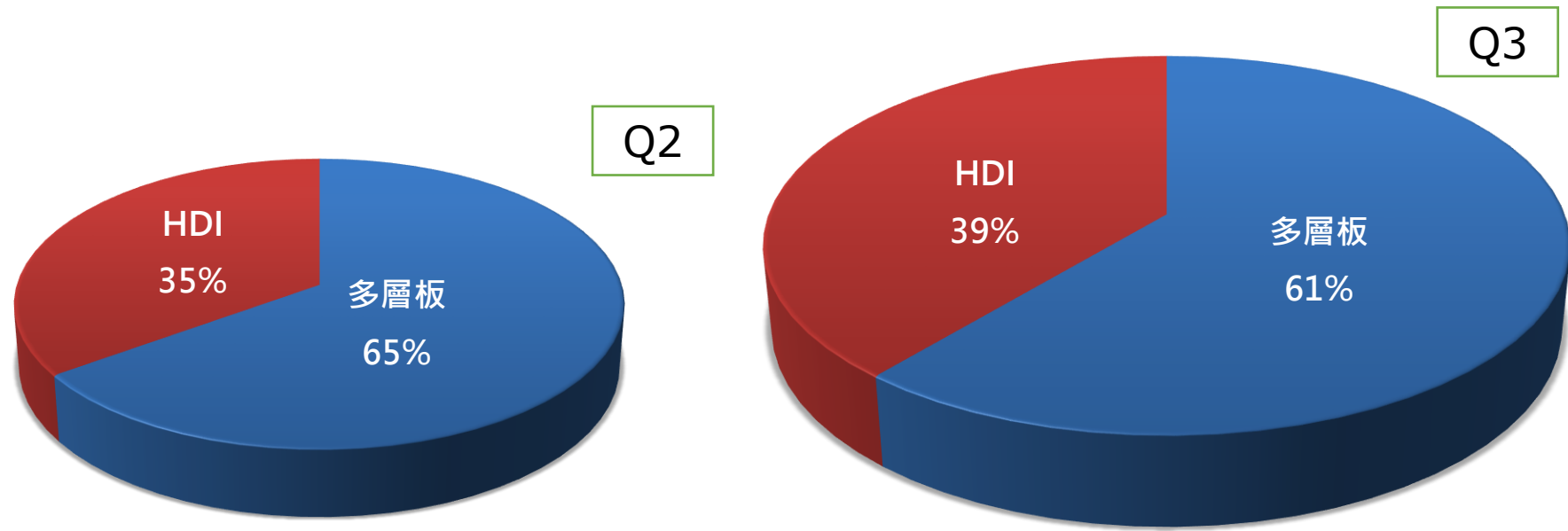
PCB 整體市場展望

- 預測 PCB 2025年的成長率為12.8%，2024~2029的年複合成長率為6.9%。
- 由AI伺服器與高速網路需求帶動的高密度互連（HDI）市場，預估將持續成長。
- 受AI伺服器與高速網路的強勁需求帶動，高層數的多層板將持續大幅擴張。
- 東南亞（SEA）的新產能將使2026年的PCB市場供應能量進一步提升。預測東南亞地區的PCB產值將迅速攀升，2024年至2029年多層板的年複合成長率為15.9%、HDI板的年複合成長率為15.7%，主要為AI伺服器、網通設備及衛星等需求所驅動。



2025年第三季營運概況

2025年第三季 銷售分析-技術別



合併損益表

綜合損益表項目 (新台幣億元)	3Q25	2Q25	單季 季變化%	3Q24	單季 年變化%	Q1-Q3 2025	Q1-Q3 2024	累積 年變化%
營業收入淨額	48.40	46.29	4.6 %	47.48	1.9 %	140.25	131.47	6.7 %
營業毛利率	19.4 %	21.5 %	(2.1)%	23.8 %	(4.4)%	19.9 %	24.6 %	(4.7)% pts
營業費用	6.09	6.15	(1.0)%	6.76	(9.9)%	18.24	18.39	(0.9)%
營業淨利率	6.8 %	8.2 %	(1.4)%	9.6 %	(2.8)%	6.9 %	10.6 %	(3.7)% pts
營業外收入及支出	(0.95)	0.89	206.4 %	(0.78)	(21.3)%	(0.13)	(0.80)	83.8 %
本期淨利	1.42	2.58	(45.2)%	2.57	(45.0)%	6.66	8.80	(24.4)%
純益率	2.9 %	5.6 %	(2.7)%	5.4 %	(2.5)%	4.7%	6.7 %	(1.9)% pts
每股盈餘(元)	0.51	0.93	(45.2)%	0.93	(45.2)%	2.40	3.17	(24.3)%
股東權益報酬率	7.1 %	14.0 %	(6.8)%	13.0 %	(5.9)%	11.2 %	14.8 %	(3.6)% pts
平均匯率	31.23	31.87	(2.0)%	32.03	(2.5)%	31.23	32.03	(2.5)%

* 2025年第三季加權平均流通在外股數為277,675仟股

** 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據

合併資產負債表及重要財務指標 〈 集團 〉

資產負債表項目 (新台幣億元)	3Q25		2Q25		3Q24	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及有價金融商品投資	33.41	10.2%	38.96	12.6%	38.06	13.6%
應收帳款	55.22	16.8%	47.27	15.3%	49.62	17.7%
存貨	40.25	12.3%	34.28	11.1%	29.23	10.4%
不動產、廠房及設備	180.18	54.8%	168.88	54.7%	146.99	52.4%
資產總計	328.50	100.0%	309.01	100.0%	280.66	100.0%
流動負債	163.12	49.7%	163.88	53.0%	151.45	54.0%
長期計息負債	67.82	20.6%	53.39	17.3%	33.43	11.9%
負債總計	249.15	75.8%	234.92	76.0%	201.42	71.8%
股東權益總計	79.35	24.2%	74.09	24.0%	79.24	28.2%
重要財務指標						
平均收現日數	113		108		106	
平均銷貨日數	92		86		75	
流動比率(倍)	0.8		0.8		0.8	
資產生產力(倍)	0.6		0.6		0.8	

註 資產生產力 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。

合併現金流量表

(新台幣億元)	3Q25	2Q25	3Q24
期初現金	38.96	35.81	43.28
營業活動之淨現金流入(出)	(1.37)	8.97	6.87
資本支出	(12.09)	(14.94)	(11.92)
現金股利	(0.00)	(4.16)	(4.17)
銀行借款	9.61	10.13	1.58
投資與其他	(1.49)	3.49	2.17
期末現金	33.41	38.96	38.06
自由現金流量	(13.45)	(5.97)	(5.04)

註 自由現金流量=營業活動之淨現金流入(出)-資本支出

2025Q3總結

- 以產品別來看，網路通訊及服務器和電腦及周邊，各增加了2個百分點，儲存裝置增加了1個百分點，主要增加的產品有：網路介面卡、AI PC及DDR5等；汽車板則減少4個百分點，主要原因包括政府取消或縮減電動車補助及關稅的影響，導致消費者延遲購車決策。從技術別來看，HDI金額增加16%，占比從35%增加到39%，顯示產品組合持續優化。
- 第二季的營收較上一季增加4.6%，出貨面積及平均單價均有提升；毛利率減少2.1個百分點，主因泰國廠毛利尚未轉正；營業費用率為12.6%，較上一季的13.3%減少，主因管理費用的減少。
- 業外支出為9500萬元，其中匯兌損失約為780萬元。稅後淨利為1.42億元，每股盈餘（EPS）為0.51元。
- 我們第三季開始大量進行認證樣品的試產，以調整並提升產線製程條件的穩定度，同時累積大量的數據，以利量產後可以短期內達到較好的良率水準。但也因此造成成本的增加，影響毛利率，預計將持續到2026年第一季小量產。
- 這些都是沒有收入的，但現在的成本投入是必要的，現在犧牲短期利潤是為了明年在AI的收穫，請大家能理解。

未來展望

2026年泰國廠AI算力擴產項目



114/11/10公告的泰國廠AI算力高階印刷電路板擴產項目，預計投入約65億新台幣。包含了P5廠2期設備的擴增，預計第三季投入生產；以及P5a廠及D1鑽孔中心，乃為滿足客戶設計層數愈來愈高及鑽孔質與量提升的要求，預計第四季投入生產。產生的效益初估為年營收65億元以上。

未來展望

- 展望2025年第四季，主要成長動能延續儲存式裝置和網路通訊及服務器，需求依舊強勁，預估營收較前期持平或小幅成長。
- 展望2026年，營收逐季顯著成長，成長動能來自於AI相關產品，AI占比將大幅提升，按照目前客戶的需求，明年AI占總體營收預估可達20%，推高營收及獲利成長。
- 隨著AI蓬勃發展，PCB技術能力已邁向更高層次、整體產值也大幅躍升。同時，客戶為確保供應鏈的穩定與彈性，要求生產基地重新佈局，定穎在此佔有領先優勢，2022年即規劃前往泰國設廠，在2024年第三季即開始量產，並且以高階製程技術為核心佈局來規劃建廠。未來定穎將以網路通訊及服務器領域為主要成長引擎，三大產品線 GPU、ASIC、Switch 同步推進，推高營收及獲利成長。車用領域憑藉深耕多年的HDI技術，自動駕駛、ADAS、智慧座艙等高階產品穩步向上。其他類型新興產品如機器人、AI PC等終端應用，亦將持續擴展，進一步強化公司多元化成長的動能。在高階產品需求持續驅動我們在產品技術和製程能力上的提升，我們對於未來營收及獲利成長抱持正面且樂觀的展望。

定穎在ESG的作為

我們近期接獲以下肯定：

- 榮獲「2025 第18屆台灣企業永續獎」，包括綜合績效：『台灣百大永續典範企業』及永續報告：銀獎。
- 被【天下雜誌 X 桃園市政府】評選為桃園1.5°C典範企業。經由《天下雜誌》與東海大學合作之「企業減碳溫度計 (TRIPs) 」精準計算，達成符合巴黎協定1.5°C標準之減碳規範。
- 榮獲《商業周刊》「2025碳競爭力百強」。



Q&A

Dynamic Holding Co., Ltd.